盈新发展董事长王赓宇：

资本并购驱动上市平台产业内核重塑



长兴半导体生产线 公司供图



长兴半导体总部 公司供图

“产业是树，资本是水。水多则涝，水少则旱，资本的作用最终由产业根基决定，这个次序不能颠倒。”无论是中国人民银行金融研究所博士后的经历，还是过往的投资履历，都让外界对盈新发展董事长王赓宇的关注更多聚焦在“产业投资人”身份上。重整新华联、文旅地产重资产业务逐步出表、跨界并购长兴半导体实现半年报业绩扭亏等一系列资本运作果断、精准又麻利——“卖是坚定果断地卖，并购也是一拍即合”——这位85后 “掌舵人”在资本市场中的形象专业又果敢。

近日，王赓宇接受了中国证券报记者专访。对于产业并购和上市公司未来的发展，他的规划非常明晰：预计半导体存储行业的高景气周期还将持续，公司将依托长兴半导体，继续通过并购等方式在行业内横向、纵向拓展。“并购不是给上市公司‘涂脂抹粉’，而是给产业‘换骨架、换血液、换发动机’。”王赓宇说。

● 本报记者 张楠 董添

存储行业高景气周期有望延续

在收购长兴半导体之前，盈新发展就已经确立了向科技领域拓展的战略方向。王赓宇向记者坦言，选择长兴半导体是偶然，但上市公司转型却是必然。2025年10月份开始筹划收购事项，到次年1月正式签订协议并发布收购长兴半导体控制权的公告，只用了3个多月时间。

“我们很看好未来一段时间存储行业的发展，景气窗口仍有一段周期，长兴半导体的发展态势会比较不错。”王赓宇说，“存储是AI时代的基础领域，其本身既是周期型行业，也是资金推动型行业。”

今年7月，公司已完成收购长兴半导体60%控制权。根据盈新发展半年报，上半年公司半导体存储芯片实现营业收入2.92亿元，占营收比重为27.93%，是公司主要的收入来源之一，稳步实现战略转型。

2026年存储行业进入AI算力驱动的超级景气周期，供需偏紧、价格大涨，但涨幅自三季度起放缓。对于近期存储行业估值回调，王赓宇认为，该行业阶段性回归理性可以让投资人更好地选择优质标的，选择业务相对成熟的企业。“行业永远有周期，但是我们的目标是成为一个优秀的企业。”王赓宇说，即使未来行业景气度放缓，好公司依然有空间，依然可以赚钱。

围绕长兴半导体进行产业并购

每年看上千个项目、每天见5-6拨投资人，这样的节奏，王赓宇表示早已习以为常。“如果看到好的项目，还是会尽可能去实地尽调，平均每年会实地考察五六十个核心项目。并购长兴半导体后，看的项目主要围绕半导体产业链上下游。”

“收购长兴半导体只是第一步，既是压舱石，也是产业根基。”王赓宇表示，长兴半导体为专精特新“小巨人”企业，具备扎实的技术底盘与稳健的产业基本盘。“在本次并购研判阶段我们就考虑到，即便在保守情景下，长兴半导体也可依托成熟封测制造能力，提供专业化先进封测代工服务，拥有稳定客户基础与订单支撑。”按照王赓宇的规划，通过联动长兴半导体，打通国产存储芯片、先进封装、内存模组的研发-生产-供应链协同链路，锚定算力、云计算、大数据核心赛道；充分调动海内外科创与产业资源，匹配各地产业规划及支持政策，落地广东、江苏、山东、重庆等存储生产基地，联动整合上下游资源，构筑具备持续核心竞争力的国产存储产业集群。

深耕产业投资多年，王赓宇对产业并购有自己的见解：金融是扶持产业的工具。对上市公司经营者而言，上市平台首先是产业载体，其次才是资本工具。不以短期市场评价决定产业取舍，不以题材热点维持关注度。无论估值和市场如何起伏，都要坚持把资源持续投向主业能力建设，用耐心和长期主义培育并实现并购后的产业发展。

在王赓宇看来，科技革命和产业变革趋势明确了要以新一代智能制造为主攻方向，发展策略上要更加注重数智赋能，技术路线上要更加注重高端自主，生产方式上要更加注重绿色低碳，场景业态上要更加注重跨界融合，着力推动制造业智能化、绿色化、融合化发展。他相信未来资本市场会有更多经典案例沿着这条道路去实践，把“单一企业简单模式的单打独斗”，变成“一个上市平台整合全链条的科技基础和专业资源”，通过一系列高水平的并购整合，助推原有产业实现跨越式发展。

“资本市场需要培育发展出龙头上市公司，由龙头来引领市场。”王赓宇认为，龙头企业的分量，不只在自身规模，更在于能否以产业整合能力带动上下游一起做强。并购整合做到深处，上市公司才能从细分领域的“小而美”，成长为产业链的链主和行业龙头。

“要转型就真转，按名门正派‘降龙十八掌’的打法好好干。”王赓宇有一套并购“心法”：上市公司首先需要主责主业清晰，盈新发展希望后续通过并购，丰富半导体存储领域的生产线，让上市公司既有生产能力，也有技术领先性。另外，从市值管理的角度看，培育主业的同时，通过并购整合优质资源，达到强链、补链的效果。他强调，希望盈新发展在并购的探索上能够不脱实向虚，不炒壳离场，而是把上市公司当成产业载体，用并购把新主业种进去。

路径上，王赓宇把并购整合分成三条主线：横向整合，围绕存储封测、模组制造提高行业集中度，巩固规模优势，提升定价话语权；纵向整合，把关键材料、关键设备、关键工艺、关键渠道纳入可控体系；补链强链，则在研发、封测、模组、主控芯片等环节补齐短板、锻强长板，让国产存储链条真正贯通。三条主线并进，指向同一个目标——把上市公司做成真正意义上的产业龙头。

近年来，跨界并购在资本市场屡见不鲜，不少企业力图通过并购重组涉足科技行业。然而跨界之后，如何达到产业协同相互赋能、充分发挥资本市场优势、兑现承诺的业绩，始终是摆在上市公司面前的一道难题。

对此，王赓宇说：“上市公司目前持有长兴半导体60%股权，这样的持股比例，使得上市公司既可以实现控股，又能让原有团队保持积极性。”大的研发方向、全球市场拓展、高管团队搭建等方面，由上市公司决定；日常性的业务生产、人员整合和一般组织架构，由长兴半导体自主决定。上市公司在财务、法务、人力等方面运行规范性更高，对长兴半导体打造品牌力、上下游客户影响力、增加企业资源都有助益。

对于并购资金来源，王赓宇对记者表示，长兴半导体营运资金状况整体比较好，政策对于并购贷也比较支持。根据公司今年8月披露的向特定对象发行股票预案，募集资金不超过17.79亿元，拟主要投向先进封测及存储模组制造、存储器主控芯片研发、补充流动资金和偿还银行贷款项目。

永远保留第二增长曲线

入主上市公司之前，王赓宇深耕科技领域投资多年。在采访过程中，王赓宇多次提及他对科技投资的一些感悟，“科技是服务于人，不是代替人。”

“我会永远保留第二增长曲线。”谈及如何应对科技领域的强周期性，王赓宇如是说。围绕“服务于人”的理念以及上市公司在文旅运营、资产管理等业务多年的积累，公司的第二增长曲线关注科技与文旅融合、科技与资管融合的相关项目。

“文旅属于大消费领域，不会像科技领域这样剧烈波动，但同样需要科技赋能。”王赓宇对记者表示，公司在探索一些科技含量比较高的文旅科技融合项目。公司将以科技为主业，关注科技与其他产业融合的成长性赛道，“腾笼换鸟”把文旅存量做轻、做稳。之前新华联文旅的重资产项目折旧大，对利润侵蚀高，西宁地产等项目已经出表，湖南长沙铜官窑拟通过北京产权交易所公开挂牌增资扩股，有望出表。

“公司会通过并购的方式寻找第二增长曲线，对冲半导体存储行业的强周期特性。通过并购和第二增长曲线的打造，上市公司把技术、产能、渠道、人才、资质与场景等重新组织成更有效率的产业地图，以资本推动、产业整合双轮驱动的方式去夯实产业，实现项目发展和产业跃升。”王赓宇说。

在他的构想中，这一系列产业布局，最终指向国产算力存储产业链自主自强的宏大命题。以并购为纽带串联创新链、产业链、资金链、人才链，于周期起伏之中涵养定力、积蓄势能，锻造新质生产力，聚力构筑安全韧性的数字基础设施，奔赴AI时代产业发展的新蓝海。

首套专属质量管理体系标准落地

国产半导体装备求解“信任”难题

● 本报记者 杨洁

11月24日，2026年集成电路行业质量大会暨半导体设备及零部件行业标准推进会在北京召开，会上正式发布《半导体设备与零部件质量管理体系》行业标准。这是国内半导体设备与零部件领域首套专属质量管理体系标准，由中国电子技术标准化研究院组织协调、北方华创牵头联合产业链40余家单位历时三年编制完成。

中国电子技术标准化研究院院长刘贤刚表示，当前，我国集成电路产业正处于从规模增长转向质量提升、自主可控的关键阶段。半导体设备与零部件贯穿设计、制造和封测，可靠性、一致性和洁净控制水平很大程度上决定芯片能不能稳定量产。过往通用的GB/T 19001质量管理体系提供了基础框架，但还不能完全覆盖这一行业在研发创新、特殊过程、供应链管理和全生命周期服务上的特殊要求。专用管理标准的缺失，是质量提升的一块现实短板。

如今，这项行业标准的发布，将确立起行业质量的“基准”和实现提升质量的“台阶”。正如北方华创董事长赵晋荣所说，中国半导体装备与零部件行业从此有了统一的质量语言、统一的管控标尺。产业有望告别粗放发展，全面迈入标准引领、质量制胜的新阶段。

仍需跨越深水区

中国工程院院士吴汉明是我国半导体产业发展的见证者，他在演讲中提起了一段二十多年前的往事。据他回忆，2005年前后，北方华创第一台12英寸刻蚀设备准备进入客户产线时，该产线运行主管甚至还曾担心“会不会爆炸”。吴汉明说，如今，国产半导体装备产业已经完成了从0到1的系统性突破，主设备门类基本补齐，2025年国产装备在国内市场的占有率达到30%。但他也表示，国产半导体装备从“能用”到“好用”以及“赢得信任”，仍有很长的路要走。

“差距不在于某一个参数，而在于长时间运行中的一致性与稳定性。”吴汉明强调，“我们缺的已经不主要是技术，而是信任，以及信任背后的质量标准体系，尤其是半导体上游的零部件与材料领域，更需要统一的标准和质量管理体系来支撑。”

赵晋荣的发言，呼应了这一判断。他指出，近年来，在全产业链协同努力下，我国集成电路产业实现长足进步、快速突破。但也要清醒看到，对标国际顶尖水平，产业整体质量仍存在明显差距，“这种差距，不仅是单个企业的质量差距，更是整个供应链、整个产业生态的系统性质量差距。”他表示，产业提质升级，靠的不是少数企业孤军奋战，而是全产业链协同进阶、全生态整体跃升。

北方华创副总裁、首席质量官王洋告诉记者，半导体设备及核心零部件，是集成电路产业行稳致远的重要根基。设备与零部件的质量水平，直接决定了芯片的性能表现、运行可靠性与量产稳定性，更是推动集成电路全产业链高质量发展的核心支撑。当前，我国集成电路产业迈入自主创新、高速发展的关键阶段，但行业专属质量管理体系标准的缺位，逐渐成为制约产业迭代升级、向高端领域突破的现实瓶颈。

标准的价值在于让采购有依据、让验收有方法、让互信有凭证。中国工程院院士钟志华表示，做出一台好设备是本事，做出一百台都一样的设备，才是产业能力；这样的批量一致性，正是靠过程能力、供应链管理和质量体系建立起来的，不是靠最后一道检验挑出来的。此次《半导体设备与零部件质量管理体系》行业标准的落地，正是破解集成电路行业质量管控痛点的关键举措，也是推动集成电路全产业链协同提质的重要纽带。

一颗合格零部件的反思

作为半导体设备核心零部件企业，富创精密代理CEO孟强在会上没有谈成绩，而是坦诚复盘了一次零部件问题的处理过程。他介绍，富创精密曾为某家晶圆厂的刻蚀设备供货一个零部件，但跑线时出现PA问题，某项元素超标。“这颗零部件本身很简单，我们经过全过程核验，确认按照现行标准是一颗合格的零部件。”孟强说，问题的发生具有很强的偶然性，最后我们与客户协商，脱离现行标准，把各项标准单独加严，再用项目流程来保障落地。

孟强说，这样的事情可能在很多企业都会发生，他抛给全场两个问题：为什么所有过程都是合格的，最后却会导致工艺的失效？靠特殊加严、靠特例来执行，真的是产业未来共同的方向吗？他认为：“现有标准的颗粒度覆盖不到制程真正关心的微观参数。如果每家零部件公司都靠特殊加严、靠特例来解决问题，产业化的效率无疑会被拖住。”

孟强强调，国产设备从零星试用走向大批量交付，竞争焦点已从“能不能造出来”转向能否稳定、一致性交付；零部件的稳定性与一致性直接决定整机可靠性，零部件与材料仍是产业链尚未完全攻关的最后一环。

据他分析，在制程窗口收窄之后，零部件的表面形貌、洁净度、尺寸一致性等微观参数，已经从配套选项变成了影响良率的核心变量，但是，行业的质量视角目前其实还集中停留在晶圆和设备两个层级，缺少对于零部件底层工艺的认知和统一的判定标尺，从零部件参数到设备表现再到晶圆良率的对应关系尚未真正建立。

“过去面对质量问题，我们首先想的是反查加工过程，急于证明自己没问题，基本不太介入下游过程。”孟强说，现在我们认为应该主动和下游协同，站在终端制程需求角度对最终制程表现负责，把过程质量透明化，与客户一起定位根因，把经验沉淀为上下游共享的公共资产，在思维上从“我们有没有问题”转变为“我们能为产业解决什么问题”，国产化越走越深，产业链越来越是“一荣俱荣、一损俱损”的情况。

让“信任”有据可依

为什么半导体装备需要一套自己的质量体系？赵晋荣介绍，汽车制造是大批量、流水线、标准化生产，半导体装备却是多品种、小批量、高定制化的离散型精密制造。一台高端设备包含数万个零部件，对应晶圆厂上千道工序、上万个可调工艺参数，要求纳米级精度、超高洁净度、超高可靠性，必须7×24小时长期稳定运行，传统制造的质量逻辑，根本无法满足半导体装备的极端工况要求。

而放眼高端制造业，汽车行业有IATF 16949，医疗器械行业有ISO 13485，轨交、航空航天行业也各有专属质量标准体系。赵晋荣说，长期以来，我国集成电路装备与零部件领域一直沿用通用的GB/T 19001标准。刘贤刚指出，这套通用标准提供了基础框架，却覆盖不到研发创新、特殊过程、供应链管理和全生命周期服务上的特殊要求，专用管理标准的缺失是一块现实短板。

补齐这块短板的，正是此次发布的行业标准。据介绍，《半导体设备与零部件质量管理体系》行业标准由北方华创牵头，联合用户企业、设备企业、零部件企业等，汇聚50多位专家，历时三年、五轮研讨编制完成。

王洋介绍，此次发布的行业标准以GB/T 19001通用框架为基础，新增129个行业条款、58项核心要求，覆盖领导职责、资源管控、设计变更、供应链、风险预防、生产交付的全流程；“零缺陷”写入最高管理者职责，整机与关键零部件实行序列号与批号双追溯。

刘贤刚用三个比喻概括标准的意义：首先，这项标准树立起行业质量的“基准”。针对通用质量管理体系难以覆盖高洁净、高可靠、多品种小批量等行业特点，这项标准明确了专用要求，使设备与零部件的可靠性有了可核对的依据。其次，这项标准形成上下游共用的“标尺”。有了这把标尺，设备企业可以据此完善体系，芯片制造企业可以据此评价供方，双方有了统一的质量尺度。再次，这项标准铺好质量提升的“台阶”。有了这个台阶，企业可以沿着产业链已有实践转化的可执行要求，改进工艺、提升质量。

围绕标准落地，吴汉明发出“三方行动”倡议：芯片制造企业应该发挥牵引作用，开放产线验证机会，客观评价、结果互认；装备整机龙头企业以标准立设计、立制造，公开可靠性与验证数据，敢用国产零部件；零部件和材料企业则应对标标准、分级认证，保证批次一致性、全程可溯源。他同时呼吁建设产业公共中试平台，做标准的输出者、验证者与经验的共享枢纽。

首套行业质量管理体系标准发布只是起点。国产半导体设备及零部件从“能用”到“好用”到“信任”，最终要靠时间、产线和数据一点点“喂”出来。以标准凝聚共识，以质量赢得信任，以信任造就产业，正如孟强所说，“这条路不会短，但是方向非常清楚”。